



第 25 届电子封装技术国际会议

2024年8月7-9日 中国·天津

<http://www.icept.org>

演讲题目: 异构集成模块封装技术趋势

演讲人: 陈光雄 副总裁 中国台湾日月光集团

演讲摘要:

包装的技术类型及发展趋势

先进封装技术介绍

系统级异构集成模块技术方案

演讲人简介:

陈光雄是中国台湾日月光集团中央开发工程高级副总裁，目前负责半导体封装研发。

他从事半导体封装技术 30 多年，经历了大部分的组装技术，包括铜线键合，MEMS 和光学传感器，倒装芯片凸点，先进封装和系统封装技术。不仅要有技术，还要有操作经验。

在 2013 年和 2014 年期间，Scott 还担任了半台湾工业协会 MEMS 委员会的副主席。他是许多论坛和峰会的特邀演讲人。西部半导体、台湾半导体、IMPACT、ECTC 和 ICEPT。

毕业于台湾国立大学化工系，并获 EMBA 硕士学位。